

報道関係者各位

2010年6月24日

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

---

**Intel Core i7 と X58 チップセット用に最適化された DDR3 トリプルチャネルメモリー**  
**容量 12GB(4GB × 3 枚セット)、CL=9-9-9-24、DDR3-1600MHz**  
**XMP 対応、アップグレード用のコネクタを搭載、Airflow ファン同梱**  
**DOMINATOR シリーズ CMP12GX3M3A1600C9**

---

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel Core i7 と X58 チップセット用に最適化された DDR3 トリプルチャネルメモリー、容量 12GB (4GB × 3 枚セット) DOMINATOR シリーズ CMP12GX3M3A1600C9 を 2010 年 6 月 26 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

DOMINATOR シリーズ CMP12GX3M3A1600C9 は、PC3-12800(DDR3-1600MHz) 規格のデスクトップ用 240Pin DDR3 メモリーです。トリプルチャネル動作に最適な 4GB メモリーの 3 枚セットです。Intel Core i7 と X58 チップセットのプラットフォームで最適なパフォーマンスが発揮できるよう設計されています。将来的なアップグレードやアクセサリーを装着するための新しいコネクターを搭載しています。冷却用の AirFlow ファンを同梱したハイエンドモデルです。



DOMINATOR モジュールは、厳密なテストとスクリーニングを実施し、最適なものだけを選定したメモリーモジュールです。選別されたチップは高いオーバークロック耐性をもちます。また各機器との相互運用性や各 IC の高周波性能、低レイテンシ性能のテストを徹底的に行い、厳しい基準をクリアしています。高い信頼性と最高のオーバークロック性能を提供します。

放熱を最大化すると同時に信頼性を向上させる CORSAIR 独自の冷却技術 DHX (Dual-Path Heat Exchange) を搭載しています。DHX は伝導と対流という 2 つの熱消散経路で従来では難しかったプリント板(PCB)内の冷却を実現しています。

効率の良い伝導熱消散経路を構築するために、特別なプリント板(PCB)を採用しています。プリント板(PCB)のグラウンド層に銅を採用することにより、プリント板内の熱を内側のアルミニウムヒートシンクへ伝導させ効率よく消散します。この熱消散経路は非常に効果的に、チップの背面から生じる熱を除去します。

Intel が独自に仕様を策定した規格、XMP (Extreme Memory Profile) に対応しています。SPD を拡張し自動的にメモリーのオーバークロックを行なう機能です。XMP 対応マザーボードにて、簡単に安定したオーバークロックを行うことができます。

型番は CMP12GX3M3A1600C9。容量は 4GB × 3 枚の合計 12GB。メモリー規格は PC3-12800(DDR3-1600MHz)、デスクトップ用 240Pin DIMM メモリー。転送クロックは 1600MHz。CAS レイテンシは CL=9-9-9-24。DHX ヒートシンク搭載。サイズは 53 × 133mm。AirFlow ファンを同梱しています。永久保証が提供されます。

## 【CMP12GX3M3A1600C9 製品特徴】

### ・Intel Core i7 & X58 チップセット用に最適化されたメモリー

DOMINATOR シリーズ CMP12GX3M3A1600C9 は、PC3-12800(DDR3-1600MHz)規格のデスクトップ用 240Pin DDR3 メモリーです。トリプルチャンネル動作に最適な 4GB メモリーの 3 枚セットです。Intel Core i7 と X58 チップセットのプラットフォームで最適なパフォーマンスが発揮できるよう設計されたモデルです。

### ・最適なチップのみを採用した DOMINATOR シリーズ

厳密なテストとスクリーニングを実施し、最適なものだけを選定したメモリーモジュールです。選別されたチップは高いオーバークロック耐性をもちます。また各機器との相互運用性や各 IC の高周波性能、低レイテンシ性能のテストを徹底的に行い、厳しい基準をクリアしています。高い信頼性と最高のオーバークロック性能を提供します。

### ・放熱を最大化する独自の冷却技術 DHX

DHX(Dual-Path Heat Exchange) は、放熱を最大化すると同時に信頼性を向上させる CORSAIR 独自の冷却技術です。メモリーモジュールから熱を効果的に除去するために伝導と対流という 2 つの熱消散経路を利用しています。

### ・プリント板も冷却する優れた伝導熱消散

効率の良い伝導熱消散経路を構築するために、特別なプリント板(PCB)を採用しています。プリント板(PCB)のグラウンド層に銅を採用することにより、プリント板内の熱を内側のアルミニウムヒートシンクへ伝導させ効率よく消散します。この熱消散経路は非常に効果的に、チップの背面から生じる熱を除去します。

### ・オーバークロック機能 XMP 対応

XMP(Extreme Memory Profile) は、Intel が独自に仕様を策定した規格です。SPD を拡張し自動的にメモリーのオーバークロックを行なう機能です。XMP 対応マザーボードにて、簡単に安定したオーバークロックを行うことができます。

### ・将来的なアップグレードに備えた新コネクター搭載

将来的なアップグレードやアクセサリーを装着するための新しいコネクターを搭載しています。※現時点でアップグレードコネクターに対応する製品情報はありません。

### ・AirFlow ファン同梱

メモリ上部に搭載する特殊なメモリ冷却システム Airflow ファンを同梱しています。Airflow ファンは、60mm 制御ファンを 2 基搭載し、メモリーサブシステムに衝突気流を発生させ冷却いたします。ほとんどのマザーボードに簡単に取り付けることができます。

### ・安心の永久保証

CORSAIR は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は永久保証です。

## 【CMP12GX3M3A1600C9 製品詳細】

型番	CMP12GX3M3A1600C9
容量	12GB(4GB × 3 枚セット)
規格	PC3-12800(DDR3-1600MHz)

種類	240Pin DDR3-SDRAM Unbuffered DIMM
転送クロック	1600MHz
サイズ	基板サイズ:39×133 mm 全体サイズ:53×133mm
レイテンシ	9-9-9-24
XMP	XMP 9-9-9-24 values at 1600MHz、1.65V
トリプルチャンネル	対応
RoHS	適合
その他	Airflow ファン 同梱
ヒートシンク	DHX 搭載
保証	永久保証

## 【CMP12GX3M3A1600C9 発売詳細】

-型番

CMP12GX3M3A1600C9

-発売日

2010年6月26日

-店頭予想売価

65,800円前後(OPEN)

-高解像度ダウンロード

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=755>

-製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/corsair-xms/cmp12gx3m3a1600c9.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

CORSAIR 正規代理店  
株式会社リンクスインターナショナル  
営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

報道関係のお問い合わせ先:

CORSAIR 正規代理店  
株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 地挽 まゆみ  
TEL: 03-5812-6143 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F  
E-mail: [jibiki@links.co.jp](mailto:jibiki@links.co.jp)  
URL: <http://www.links.co.jp>